



科研产出

- 论文 >
- 专利 >
- 专著 >

当前位置 > 首页 > 科研工作 > 科研产出 > 专利

专利名称:	一种CMP压力分布计算方法及研磨去除率的获取方法
专利类别:	发明专利
申请号:	201310571760.3
申请日期:	2013-11-13
专利号:	ZL201310571760.3
第一发明人:	方晶晶;陈岚;曹鹤
实施情况:	授权
专利证书号:	ZL201310571760.3
其它备注:	EDA中心

